



創 變 智 造 新 未 來

台達邊緣輪廓量測儀

WEP-3012-2E



台達邊緣輪廓量測儀

WEP-3012-2E

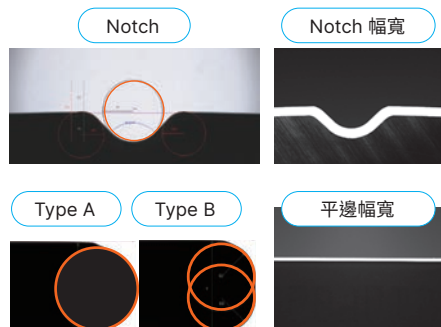
擁有完整 EFEM 實現產線自動化、並可選配粗糙度檢測模組、邊緣 AOI 檢測等功能可量測主流各尺寸矽晶圓、碳化矽晶圓、玻璃晶圓，包含 Notch、平邊及倒角形狀，並根據不同產品之倒角形狀規格，進行多組參數建置

功能與特色

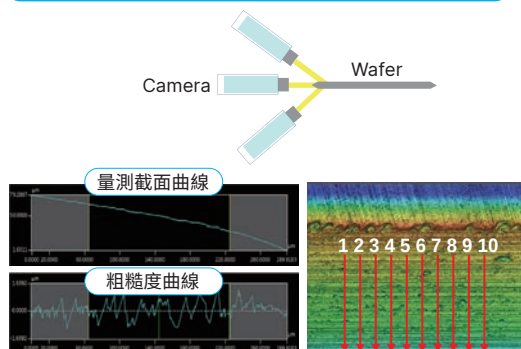
- 高速產能，每小時可量測約 60~120 pcs
- 非接觸及非破壞式量測
- 倒角量測位置可任意設定，最多達 16 點
- 量測模組具校正對標功能，並可搭配參數建置管理切換使用



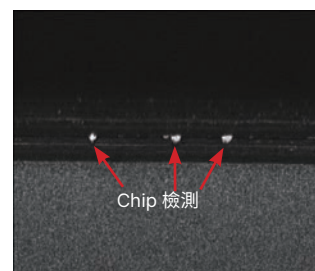
Edge/Notch 量測



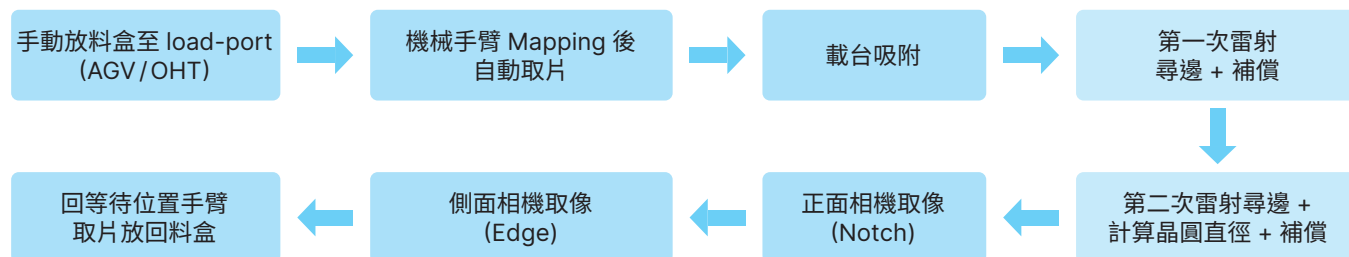
粗糙度量測



邊緣 AOI



動作流程



標準規格

型號	WEP-3012-2E
產品尺寸	12 inch
加工產品數 / 次	1 pcs
速度	60 ~ 120 pcs/hr
I/O 信號介面	Yes
通訊信號介面	Ethernet
控制器	PC-based
操作介面	一般螢幕
機架尺寸	1,750 × 2,400 × 2,475 mm
重量	約 1,500 kg
氣源氣壓	0.5 ~ 0.8 Mpa
電源電壓	220 V _{AC} , 50/60 Hz
產品進出方式	手動擺放、AGV/OHT

* 台達保有更改規格之權力，恕不另行通知

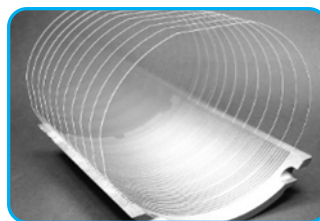
應用領域



矽晶圓



碳化矽



玻璃晶圓



台達電子工業股份有限公司
機電事業群

33068 桃園市桃園區興隆路 18 號

TEL: 886-3-3626301

FAX: 886-3-3716301

* 本型錄內容若有變更，恕不另行通知